

フォトマスク保護用粘着フィルム
Emulsion Protection Film



液状レジスト用保護フィルム

For Liquid Solder Resist

PA8X

基材厚 Base Film Thickness	粘着厚 Adhesive Thickness	セパレーター厚 Release Liner Thickness
6 μ m	2 μ m	25 μ m

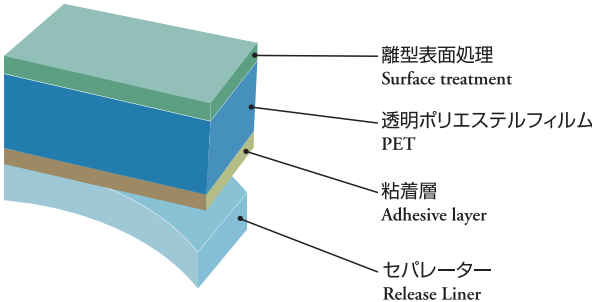
液状レジストが付着しにくく、クリーニングが容易
糊残りが無く再剥離が可能
キモテクト液状レジスト用のスタンダードタイプ

PA8X can be easily removed from the surface of the phototools and is repeelable without any remnants of adhesive.
PA8X is a standard type for the Liquid Solder Photo Resist Series.

PA8XM

基材厚 Base Film Thickness	粘着厚 Adhesive Thickness	セパレーター厚 Release Liner Thickness
6 μ m	2 μ m	25 μ m

マットタイプ使用により密着性、真空引きが向上
A matted surface improves adhesion and vacuum pressure.



特性 Properties

	PA8X	PA8XM
全光線透過率(%) ^{*1} Total Light Transmittance	92.9	92.2
平行光透過率(%) ^{*1} Parallel Light Transmittance	90.8	85.6
紫外線透過率 ^{*2} (%/365nm) UV Light Transmittance	87.9	89.5
紫外線透過率 ^{*2} (%/420nm) UV Light Transmittance	87.4	90.0
Haze(%) ^{*1}	2.1	7.2
粘着力(対PET) Adhesive Force for PET	2.5N/25mm	2.6N/25mm

^{*1}: JIS-K7105に準じて測定。セパレーターは含まれていません。
^{*2}: 島津製作所製、UV-3101PCで測定。セパレーターは含まれていません。
^{*1}: JIS-K7105 without Release Film. ^{*2}: Simazu UV-3101PC without Release Liner.

※本カタログに記載のデータは代表値であり、規格値ではありません。